

Presseinformation

Heinsdorfergrund

31.01.2017

Aufstecken – fertig – Cloud! SYS TEC electronic entwickelt frei programmierbaren IoT-Chip für eine direkte Cloud-Anbindung ohne Gateway.

Der Elektronikdienstleister SYS TEC electronic GmbH aus Heinsdorfergrund (Sachsen) hat einen aufsteckbaren Rechen-Kern zur Anbindung an die Cloud (IoT-Chip) entwickelt, welcher vom Anwender frei programmierbar ist. Im Gegensatz zu anderen IoT-Chip-Geräten vereint der IoT-Chip von SYS TEC electronic Sensor2Cloud-Anforderungen mit Datenvorverarbeitung von zeitkritischen Signalen bis hin zu effizienten Steuerungsaufgaben. Dafür sind bereits entsprechende Funktionsbibliotheken vorinstalliert, mit denen der IoT-Chip sofort einsatzfähig ist.

Die SYS TEC electronic GmbH ist ein Elektronikdienstleister in Sachsen. Der Schwerpunkt der Firma liegt in der individuellen Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Elektroniklösungen. 26 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Branchen – von der Transportindustrie über industrielle Kommunikation bis hin zur Automatisierung – wurden mit dem aktuellen Bedarf im Elektronikmarkt verknüpft. Das Ergebnis ist ein einfach zu integrierender IoT-Chip, für die Anwendung im Bereich Internet of Things/Industrie 4.0 und die damit einhergehende Verbindung von Geräten/Maschinen mit der Cloud.

Die Vorteile des IoT-Chips der SYS TEC electronic liegen im Bereich der Anwendung, Sicherheit und Cloud-Anbindung. Auf dem Chip sind Bibliotheken und Protokolle wie MQTT, Modbus oder CANopen vorhanden, die direkt einsatzfähig sind.

Die im Sourcecode mitgelieferten Vorlagen dienen dem Anwender als Ausgangspunkt für eigene Anpassungen. Über I²C und SPI können direkt Aktoren und Sensoren angeschlossen werden.

Damit kann die gesamte Messung, Steuerung und Regelung auch auf dem IoT-Chip abgewickelt werden. Der Chip funktioniert demnach autark und unabhängig von der Cloud. Bei anderen IoT-Chip-Geräten finden die besagten Prozesse typischerweise in der Cloud statt. Für die Anbindung an die Cloud wird zudem kein zusätzliches Gateway benötigt.

Der IoT-Chip von SYS TEC electronic ist M2M-Kommunikation auf höchstem Niveau, effizient und zu moderaten Kosten erhältlich.

Die erstmalige öffentliche Präsentation des Chips erfolgt auf der Fachmesse embedded world vom 14. – 16. März in Nürnberg.